

2013-2014年全球及中国IC先进封装设备行业研究报告

《2013-2014年全球及中国IC先进封装设备行业研究报告》包含以下内容：

- 1、半导体产业概况
 - 2、内存与晶圆代工行业现状
 - 3、半导体下游市场分析
 - 4、新兴先进封装技术趋势
 - 5、封装设备行业分析与排名
 - 6、15家先进封装设备厂家研究
-
- 封装设备可以分Wafer Level和Die Level两大类型，通常Wafer Level Packaging计算在Wafer设备里，因为其设备在Wafer制造过程中也有使用。Wafer Level Packaging主要应用在5个领域，分别是Analog & Mixed Signal（包括IPD、PA、PMU、Local Power、IC Driver、Audio&Video）、Wireless Connectivity(包括Bluetooth+FM+WLAN Combo、GPS Single Chip)、Optoelectronic（包括CIS、AL Sensor）、MEMS&Sensor（包括Accelerometers、Gyroscope、RF-MEMS、Pressure Sensor、Fingerprint Sensor），最后还有Misc Logic and Memory（包括Logic gate、EEPROMs）。这些大多是Fan-in设计，引脚（Pin）数量通常低于20。
-
- 未来WLCSP要扩大应用范围，必须采用Fan-out设计，不过目前Fan-out设计不够成熟。Fan-in设计限制了Wafer Level Packaging的应用范围，其市场目前来看缺乏潜力，当然如果Fan-out设计成熟，WLCSP将迎来新发展。

- Wafer Level Packaging设备包括Process Tool（主要是CVD或PVD、Etching、Sputtering）、Packaging Lithography、Contact Probers、Packaging Inspection。其中Process Tool领域主要厂家是Applied Material（包括被收购的NEXX）、ULVAC。Packaging Lithography领域主要厂家是Ultratech、SUSS、EV Group。Contact Probers领域主要是Tokyo Seimitsu和Tokyo Electron（已被Applied Material收购）。Packaging Inspection领域主要是Rudolph、Camtek、KLA-TENCOR。2014年Wafer Packaging Level设备市场规模大约13亿美元。
- Die Packaging Level设备主要包括Wire Bonder（主要厂家Kulicke & Soffa、ASM Pacific、Shinkawa）、Die Bonder（主要厂家ASM Pacific、Hitachi High-Technologies、BESI、Canon）、Flip-chip Bonder（主要厂家PFSA、BESI、ASM Pacific、Toray Engineering、Hanmi）、Test Handler（主要厂家Delta Design、Advantest、Epson、Teseq）、Wafer Dicing Saws（主要厂家DISCO、Tokyo Seimitsu）、Molding / Encapsulation（主要厂家Towa、BESI、Dai-ichi Seiko）、Package singulation（主要厂家Hanmi、ASM Pacific、DISCO）。
- 半导体设备是周期性明显的行业，2001-2007年期间处于上升期，2008和2009年连续暴跌，2010年大涨超过100%，之后从2011年开始连续3年下滑，2014年迎来爆发。预计2014年Die Packaging Level设备市场规模大增20%达到41亿美元，2015年达43亿美元，2016年再进入下降通道。主要增长点在Die Bonder、Flip-chip Bonder、Test Handler。



全球前16大封装设备厂家2013、2014年收入排名

	2013	2014E
ASM Pacific	670	850
Kulicke & Soffa	535	588
BESI	345	564
DISCO	508	516
Applied Material	308	356
Tokyo Seimitsu	310	338
Cohu	215	271
Advantest	190	258
HANMI	171	208
SUSS	150	162
Hitachi High-Technologies	138	150
PFSA	108	138
Ultratech	157	128
Shinkawa	78	110
Rudolph	95	92
TOWA	78	79

单位: 百万美元



报告目录

第一章、全球半导体产业

- 1.1、全球半导体产业概况
- 1.2、半导体产业供应链
- 1.3、半导体封装简介

第二章、IC封装行业上下游分析

- 2.1、半导体产业地域格局
- 2.2、半导体产业支出趋势
- 2.3、DRAM内存产业
 - 2.3.1、DRAM内存产业现状
 - 2.3.2、DRAM内存厂家市场占有率
 - 2.3.3、移动DRAM内存厂家市场占有率
- 2.4、NAND闪存
- 2.5、晶圆代工产业
- 2.6、晶圆代工行业竞争分析
- 2.7、晶圆代工产业排名
- 2.8、手机市场
- 2.9、PC市场
- 2.10、平板电脑市场
- 2.11、FPGA与CPLD市场

第三章、封测技术趋势

- 3.1、WIDE IO/HMC MEMORY
- 3.2、EMBEDDED COMPONENT SUBSTRATE
- 3.3、EMBEDDED TRACE SUBSTRATE
- 3.4、手持设备IC封装 IC PACKAGING FOR HANDSET
 - 3.4.1、手持设备IC封装现状
 - 3.4.2、POP封装
 - 3.4.3、FOWLP
- 3.5、SIP封装
 - 3.5.1、MURATA
 - 3.5.2、环隆电气USI
- 3.6、2.5D封装 (SI/GLASS/ORGANIC INTERPOSER)
 - 3.6.1、2.5D封装简介
 - 3.6.2、2.5D封装应用
 - 3.6.3、2.5D INTERPOSER市场规模
 - 3.6.4、2.5D 封装供应商
- 3.7、TSV (3D) 封装
 - 3.7.1、TSV封装设备

第四章、封装设备产业分析



4.1、封测产业规模

4.2、MIDDLE-END中段封测产业

4.3、封装设备市场规模

4.4、封装设备市场占有率

4.5、封装设备厂家排名

第五章、封装设备厂家研究

5.1、ASM PACIFIC

5.2、KULICKE & SOFFA

5.3、BESI

5.4、ADVANTEST

5.5、HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES

5.6、TERADYNE

5.7、DISCO

5.8、TOWA

5.9、HANMI

5.10、PFSA

5.11、SUSS MICROTEC

5.12、COHU SEMICONDUCTOR EQUIPMENT
GROUP

5.13、SHINKAWA

5.14、TOKYO SEIMITSU

5.15、ULTRATECH



图表目录

- 1990-2014 Semiconductor Industry Growth versus Worldwide GDP Growth
- 2012-2014年全球半导体产业季度收入
- 2012-2018年全球半导体市场产品分布
- Semiconductor Outsourced Supply Chain
- Semiconductor Company Systems
- Semiconductor Outsourced Supply Chain Example
- 1Q14 Top25 Semiconductor Sales Leaders
- 1990-2013 Worldwide IC Sales by Company Headquarters Location
- 2013 Fabless IC Sales Marketshare by Company Headquarters Location(77.9B)
- 2008-2013 Top 10 IC Manufacturers in China
- 2011-2014F Top 10 Spenders Capital Spending Outlook
- 1994-2013 Top 5 Share of Total Semiconductor Capital Spending
- 1Q14-WW-Semiconductor-CapitalSpending-Share-of-FullYear-Budget
- 2008-2016年全球DRAM与NAND市场规模
- 1Q/12-4Q/14 DRAM supply/demand
- 2005-2015年DRAM产业CAPEX
- 2012-2014 DDR3 4Gb ASP
- 2012-2014 NAND MLC 32Gb ASP
- 2Q13-1Q14 Revenue Ranking for Branded DRAM Vendor
- Q1/07-Q1/14 DRAM Market Share



- 2009-2011年Mobile DRAM 市场份额
- 2012年Mobile DRAM 市场份额
- 2Q13-1Q14 Revenue Ranking for Branded Mobile DRAM Vendor
- 2012 年 品牌 (Brandbed) NAND Flash厂家市场份额
- 2014年1季度品牌 (Brandbed) NAND Flash厂家市场份额
- 1Q12-4Q14 NAND Supply/Demand
- NAND tech migration roadmap
- 2008-2017年全球Foundry市场规模
- 2012-2017 Foundry Revenue of Advanced Nodes
- 2012-2018 Global Foundry capacity by node
- 2012-2018 Global Foundry revenue by node
- Global ranking by foundry
- 2008-2016年平均每部手机IC成本
- 2007-2015年全球手机出货量
- Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units)
- Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 2013 (Thousands of Units)
- Worldwide Mobile Phone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units)
- 2008-2015年全球PC用CPU与Discrete GPU 出货量
- 2008-2015年笔记本电脑出货量
- 2010-2013年全球主要笔记本电脑ODM厂家出货量
- 2011-2016年全球平板电脑出货量
- 2013年平板电脑主要品牌市场占有率



- 2012、2013年全球平板电脑制造厂家产量
- 2011年FPGA、CPLD市场下游分布与地域分布
- 1999-2013年主要FPGA厂家市场占有率
- Mobile DRAM Trend
- WIDE IO的优点
- SK Hynix WIDE IO2 Roadmap
- HMC Architecture
- HMC BENEFITS
- Advantages of Embedded Passive/Active Substrate
- Embedded Component Substrate Process
- Comparison of Embedded Active & Passive Components
- Roadmap of Embedded Passive Substrate
- Structure Roadmap of Embedded Active Substrate
- FOWLP and PLP Process Comparison
- WHY EMBEDDED TRACE?
- EMBEDDED TRACE Package Features
- EMBEDDED TRACE Package Sweet Spot (for Wire Bonding)
- EMBEDDED TRACE Package Sweet Spot (for FLIP CHIP)
- Apple iPad 4 LTE A1459 IC Package Type List
- PoP封装发展趋势
- 2014年SiP封装主要厂家市场占有率
- FY2009-FY2014 Murata Sales and Operation Margin



- FY2009-FY2014 Murata Sales by region
- 2011年1季度-2014年2季度Murata收入、新订单与Backlog
- 2011年1季度-2014年2季度Murata运营利润、净利润
- 2011年1季度-2014年2季度Murata Order by Product
- FY2010-FY2014 Murata Sales by Product
- FY2010-FY2014 Murata Sales by Application
- 2008-2014年环隆电气收入与毛利率
- 2013年1季度-2014年2季度环隆电气季度收入与毛利率
- 2013年1季度-2014年2季度环隆电气季度收入产品分布
- 2008-2014年环旭电子收入与营业利润率
- 2011-2013年环旭电子收入下游分布
- 2011-2013年环旭电子各项产品产量
- 2.5D Interposer Manufacturing Revenue
- 2010-2017 Breakdown by interposer bulk material
- TSV下游应用
- TSV设备供应商
- 2012-2017年TSV封装设备分布
- 2006-2015年OSAT市场规模
- 1990-2020 Share of IC Package Value Add
- 2011\2016 全球IC封装类型出货量分布
- Middle-End中段封测产业 Process
- 2007-2016 Die Packaging Level设备市场规模



- 2010年1季度-2014年2季度Semi Equipment Book-to-bill
- 2013、2014年Die Packaging Level设备产品分布
- 2014 Wire Bonder Vendor Market Share
- 2014 Flip-chip Bonder Vendor Market Share
- 2014 Die Bonder Vendor Market Share
- 2014 Test Handler Vendor Market Share
- ASM分支结构
- ASM太平洋产品线
- 2009-2014 ASM Pacific收入与税前利润
- 2009-2013 ASM Pacific Assets与Liabilities
- 2012-2013年ASM Pacific收入业务分布
- ASM Pacific Quarterly sales trend by Business
- 2012-2013年 ASM Pacific EBIT业务分布
- 2007-2014 ASM Pacific book-to-bill
- 2012-2013年 ASM Pacific收入地域分布
- 2011-2013 ASM Pacific收入产品分布
- 1993-2015 ASM Pacific capex/sales
- 2007-2014财年Kulicke & Soffa收入与运营利润率
- 2011-2013财年Kulicke & Soffa前10大客户
- Kulicke & Soffa全球分布
- 2011年2季度-2014年2季度Kulicke & Soffa收入
- 2011年2季度-2014年2季度Kulicke & Soffa营业利润率



- 2011年2季度-2014年2季度Kulicke & Soffa R&D 支出
- 2009-2018年Wire Bonder Equipment Market
- 2012-2018 Copper Bonder Unit
- BESI Organization
- 2009-2014 BESI Revenue and Orders
- 2009-2014 BESI Revenue \Operation Margin\Net Margin
- 1Q12-2Q14 BESI Quarterly Revenue and Orders
- 1Q12-2Q14 BESI Quarterly Revenue and Net Margin
- BESI Milestone
- 1Q12-2Q14 BESI Quarterly Expense
- 1Q12-2Q14 BESI Quarterly Headcount
- 1Q12-2Q14 BESI Quarterly Cash and Debt
- 2013 BESI Market Share
- 2013 BESI Revenue Breakdown by Product
- BESI Product Position
- BESI Product
- BESI Global Operation
- 2012年2季度-2014年2季度Advantest收入与毛利率
- 2012年2季度-2014年2季度Advantest新订单额
- FY2013-Q1/FY2015 Advantest Order by business
- FY2013-Q1/FY2015 Advantest Order by Region
- FY2013-Q1/FY2015 Advantest Sales by Business



- FY2013-Q1/FY2015 Advantest Sales by Region
- 2013年3季度-2014年2季度Advantest 资产负债
- 2007-2015财年Hitachi High-Technologies收入与运营利润率
- 2011-2015财年Hitachi High-Technologies收入部门分布
- 2011-2014财年Hitachi High-Technologies运营利润部门分布
- 2013-2015财年Hitachi High-Technologies Electronic Device Systems收入业务分布
- 2014-2015财年Hitachi High-Technologies Electronic Device Systems Front-end 收入Field 分布
- 2006-2014年Teradyne收入与营业利润率
- 2011-2013 Teradyne Net revenues by country as a percentage of total revenues
- 2011-2014 Teradyne收入产品分布
- DISCO Organization Chart
- FY2010-FY2015 DISCO收入与营业利润
- Q1/FY2005-Q4/FY2013 DISCO Quarterly Consolidated Financial Results
- Q1/FY2005-Q4/FY2013 DISCO Quarterly Sales/Orders
- Q1/FY2010-Q4/FY2013 DISCO Quarterly Sales Breakdown by Product
- Q4/FY2013 Product and Equipment Sales Breakdown
- FY2012-FY2013 DISCO Equipment, Non-consolidated Cutting and Dicing Saws Sales Breakdown by Application
- FY2012-FY2013 DISCO Equipment, Non-consolidated Grinders and Polishers Sales Breakdown by Application
- FY2012-FY2013 DISCO Consolidated Sales Breakdown by Region
- FY2000-FY2014 DISCO Consolidated R&D/CAPEX Forecast
- Towa Organization Chart
- FY2010-FY2015 TOWA收入与营业利润



- FY2011-FY2014 TOWA 收入产品分布
- FY2011-FY2014 TOWA 订单产品分布
- FY2011-FY2014 TOWA 收入低于分布
- 2010-2014 Hanmi收入与营业利润率
- 2007-2015Hanmi收入产品分布
- 2008-2014 SUSS MicroTec销售额与EBITDA率
- 2008-2014 SUSS MicroTec 订单额
- 2014年H1 SUSS Sales and Order By Segment
- 2014年H1 SUSS Sales and Order By Region
- 2008-2014 Cohu收入与营业利润率
- 2008-2014 Cohu收入产品分布
- 2011-2013 Cohu Semiconductor equipment收入产品分布
- FY2009-FY2015 Shinkawa收入与营业利润
- FY2011-FY2014 Shinkawa收入产品分布
- FY2011-FY2014 Shinkawa收入地域分布
- FY2009-FY2015 Tokyo Seimitsu收入与营业利润
- FY2012-FY2015 Tokyo Seimitsu收入产品分布
- Q1/FY2010-Q1/FY2015 Tokyo Seimitsu Semiconductor Equipment Quarterly Sales
- Q1/FY2010-Q1/FY2015 Tokyo Seimitsu Semiconductor Equipment Quarterly Order
- 2009-2014 Ultratech收入与营业利润率
- 2011-2013 Ultratech收入产品分布



购买报告

价 格	电子版: 8500元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 9000元	传真: 010-8260.1570
页数: 130页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2014-8		网址: www.pday.com.cn
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201408/24511833.html		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561

传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

